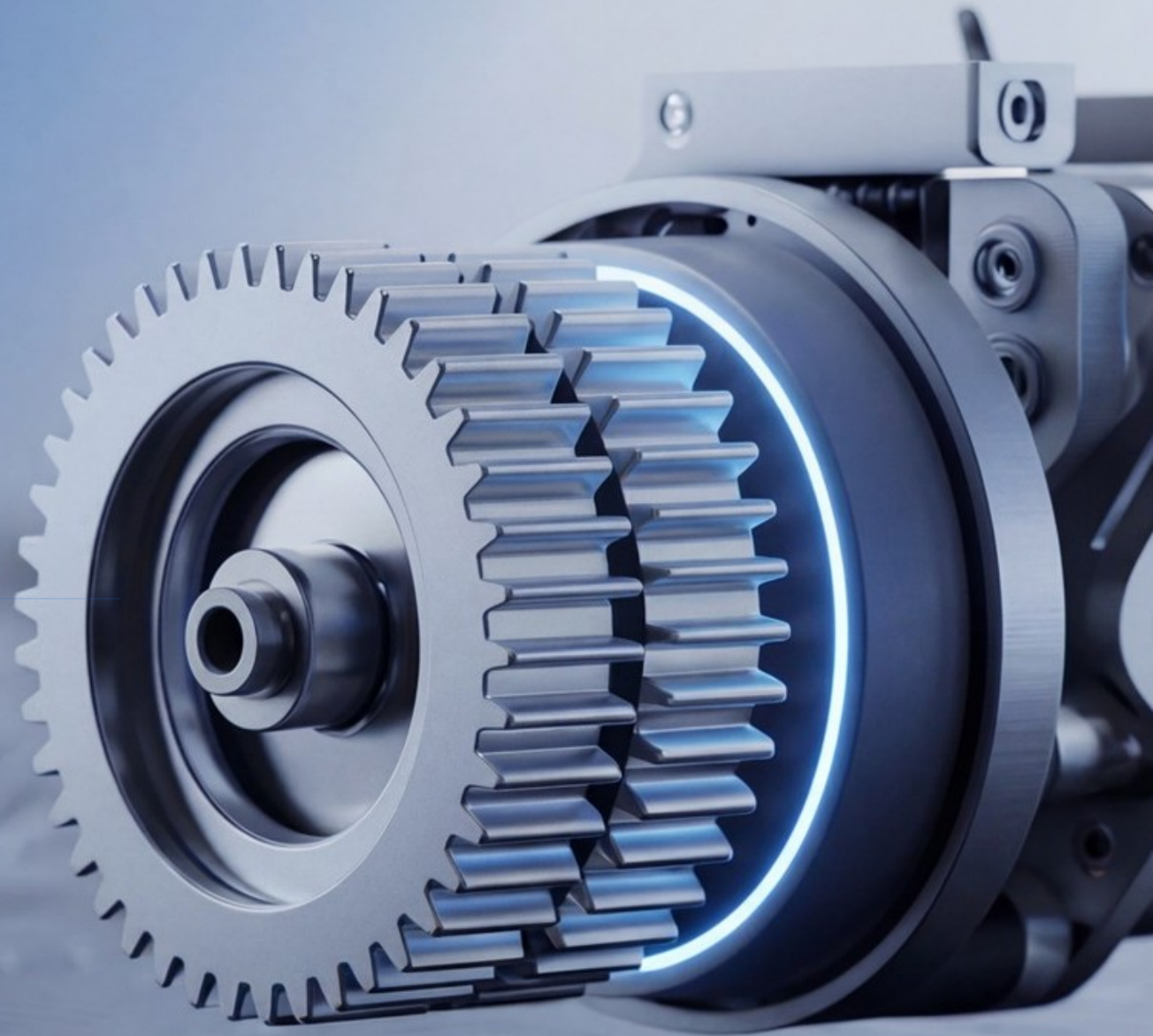


# 电子布行业景气 周期分析

AI 算力驱动下的供需紧平衡与市场机遇洞察



北京研精毕智信息咨询有限公司



# 目录

01

行业概况与核心功能

02

市场规模与价格波动

03

全产业链结构剖析

04

供需格局深度解析

05

核心企业与竞争格局

# 行业概况与核心功能

电子布作为电子信息产业的“隐形骨架”，其性能直接决定了高端电子设备的效能。本章节将深入解析电子布的产品定义、核心功能及下游应用场景，揭示其在现代科技产业链中的基石地位。



# 电子布产品定义

## 电子信息产业的“隐形骨架”

01

### 材料构成

由直径不足 9 微米的电子级玻璃纤维纱经精密交织制成，是一种高端工业织物。

02

### 核心特性

具备高精度、低介电、高耐热、高绝缘、低膨胀等优异特性，是普通玻纤织物无法替代的。

03

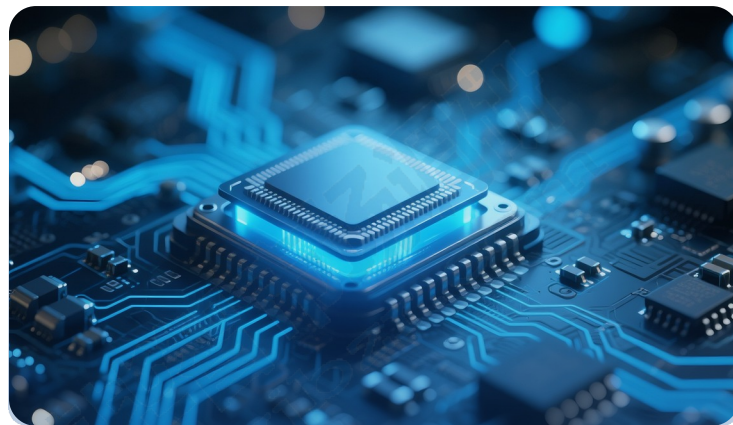
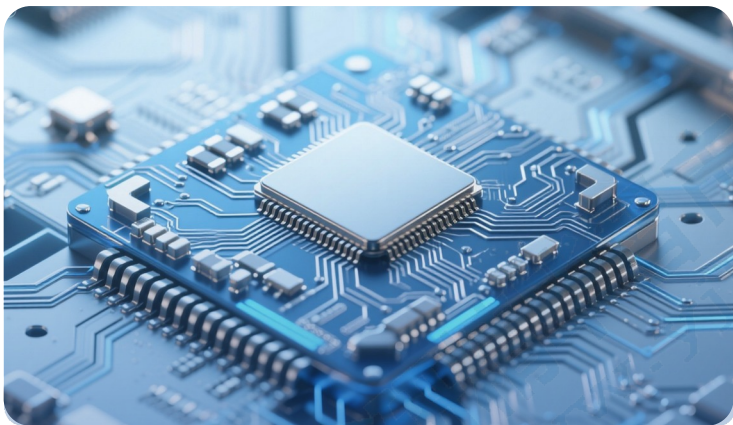
### 规格分类

主要分为普通 E 布、低介电 ( Low-Dk ) 布、低膨胀 ( Low-CTE ) 布、石英 ( Q ) 布四大品类，技术壁垒逐级升高。



# 核心功能与应用

## 承载电子设备的结构与信号



01

### 三大核心功能

在 PCB 中承担机械支撑、电气绝缘、信号传输三大核心功能，是电子设备正常运行的基础。

02

### 下游应用场景

广泛应用于 AI 算力服务器、数据中心、5G/6G 基站、智能手机、新能源汽车电控系统等高端电子产品。

03

### AI 服务器需求

单台 AI 服务器 PCB 用量是传统服务器的 3-5 倍，对超薄、低介电等高端电子布的需求呈爆发式增长。

# 市场规模与价格波动

在 AI 算力需求的强力驱动下，电子布行业迎来了历史性的景气周期，价格实现翻倍上涨，市场规模持续扩张。本章节将聚焦市场数据，剖析价格波动的现状与趋势。



# 市场规模持续扩张

## 行业进入高增速发展阶段

01

### 2025 年市场规模

- 中国电子布行业市场规模已成功突破 180 亿元，行业整体进入规模化、高增速发展阶段。

02

### 2026 年市场预测

- 预测 2026 年国内电子布市场规模将攀升至 200-220 亿元区间，同比增速维持 11%-22% 的高位增长水平。

03

### 增长核心动力

- AI 服务器、5G 基站、汽车电子等下游领域的需求爆发是市场规模持续扩张的核心驱动力。



# 价格翻倍暴涨

## 供需紧平衡下的五轮提价

### 提价历程

截至 2026 年 6 月初，国内市场主流规格电子布已完成年内 5 轮集体提价，行业均价从 3.7 元 / 米暴涨至 7.4 元 / 米，涨幅达 100%。



### 结构性涨价

高端产品涨幅更大，低介电布、石英布因供需缺口突出，市场涨幅普遍突破 120%；普通 E 布涨幅维持在 80%-100%。

### 库存降至低位

当前行业库存水平已降至 7-12 天的历史低位，远低于 30 天的常规安全库存标准，加剧了现货紧张局面。



# 全产业链结构剖析

电子布行业产业链各环节壁垒分明，从上游原材料到下游终端应用，形成了“上游卡设备、中游卡技术、下游强需求”的典型结构。本章节将逐一拆解产业链各环节的现状与瓶颈。



# 上游：原料与设备

## 产能扩张的核心制约因素



### 01 核心原料

电子纱是电子布的核心原料，也是主要成本来源，其生产依赖叶腊石、高纯石英砂等矿物原料。

### 02 供给瓶颈

国内电子纱行业集中度高，但供给弹性不足；高端织造设备高度依赖进口，交付周期长达 18-24 个月，是产能扩张的主要瓶颈。

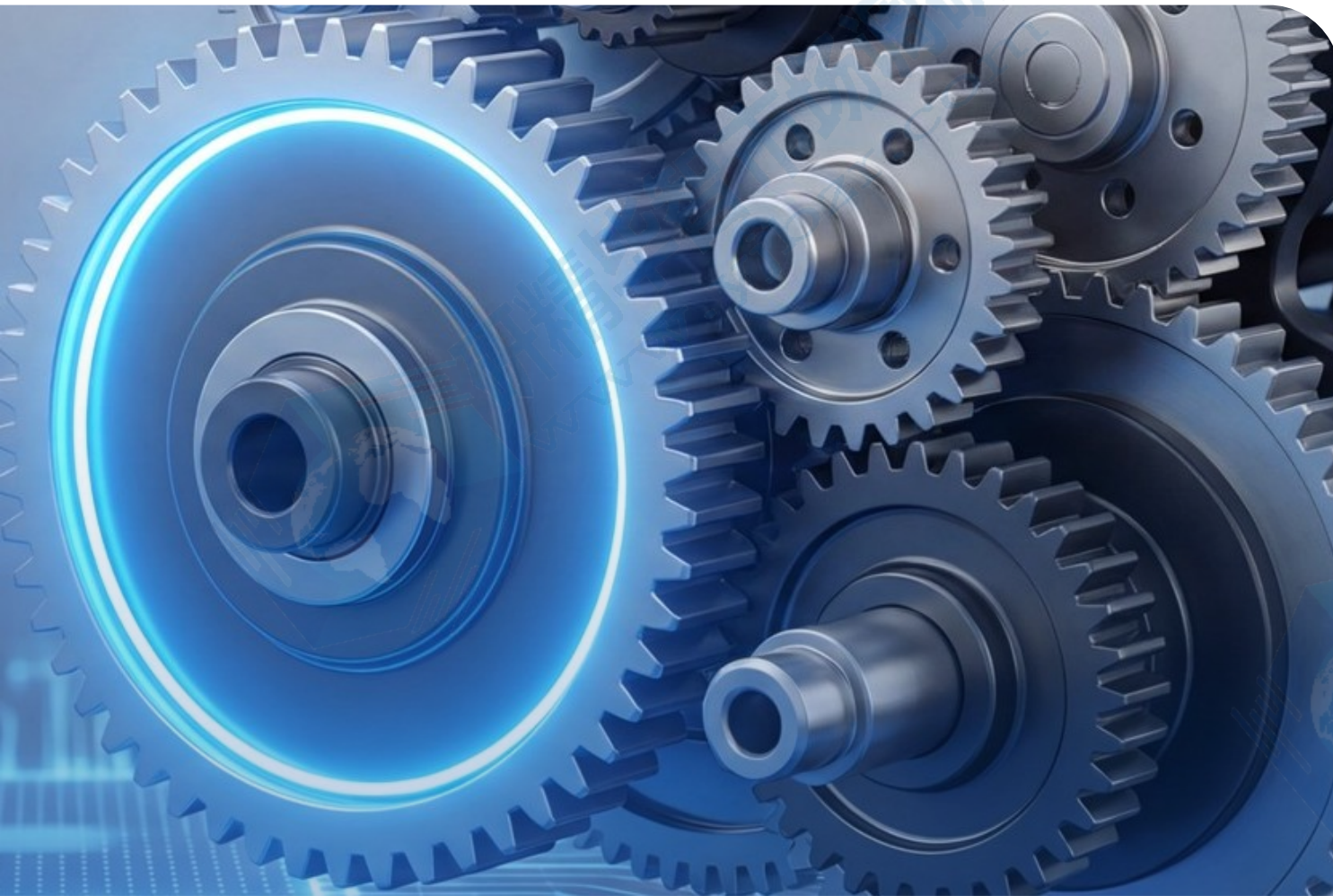
### 03 成本传导

2026 年国际原油价格上涨，带动双酚 A、阻燃剂等配套化工辅料价格涨幅超 40%，进一步推高生产成本。



# 中游：织造与加工

## 技术分层明显的价值核心



01

### 技术壁垒

高端电子布对介电常数、热膨胀系数、平整度等指标要求严苛，需要长期工艺积累，技术突破难度大。

02

### 产能缺口

2026 年上半年国内电子布新增需求折合产能 12.7 亿米，有效新增产能仅 4.3 亿米，整体供需缺口达 8.4 亿米。

03

### 产品分化

中低端普通 E 布已实现国内规模化生产，但供给出现 10%-15% 缺口；高端产品国产化率不足 20%，供需形势更为紧张。

# 下游：覆铜板与终端

## AI 算力驱动的需求核心

01

### 核心需求

AI 服务器是本轮行业增长的核心动力，2025 年全球高端 AI 服务器出货量大幅增长，带动高端特种电子布需求增速突破 50%。

02

### 需求结构

下游形成以 AI 算力为核心，消费电子、汽车电子、通信设备协同发力的需求格局，对电子布的性能和数量提出更高要求。

03

### 国产替代

受全球供应链安全等因素影响，国内头部企业逐步减少海外高端电子布采购，转向国内优质供应商，加速了国产替代进程。



# 供需格局深度解析

当前电子布行业已进入 AI 算力驱动的结构性高增长新阶段，需求总量持续扩张，而供给端则因多重壁垒锁死产能，短期内无扩容空间，形成了极致的供需错配。



# 需求端：结构性爆发

## AI 重构行业增长逻辑

01

### 总量扩张

行业整体需求持续扩张，国内电子布月度供需缺口达 800-900 万米，全年整体缺口预估接近 3 亿米。

02

### 结构升级

需求分化极为明显，低端普通布需求稳步增长，而 AI 专用石英布、低介电布需求则呈现爆发式增长。

03

### 客户锁定

下游客户为保障供应链安全，纷纷锁定长期采购订单，进一步加剧了现货紧张格局，推动价格持续上涨。

# 供给端：产能被锁死

## 四重壁垒制约产能释放

### 设备交付壁垒

高端进口织机、后处理设备交付周期长达18-24个月，且全球设备产能紧张，新增产能至少需至2027年下半年才能逐步释放。

S

W

### 生产工艺壁垒

电子布池窑生产线需24小时不间断高温燃烧，从基建到量产达标，整体周期长达18-24个月。

### 客户认证壁垒

高端电子布需通过下游企业2-3年的长期认证，新进入者无法快速切入核心供应链。

O

T

### 全球产能调整

日本、中国台湾地区头部企业持续关停普通E布产能，转产高毛利的高端电子布，导致中低端市场供给持续收缩。



# 核心企业与竞争格局

全球电子布产能主要集中于日本、中国台湾、中国大陆三大区域，行业呈现“高端海外垄断、中低端国内主导”的分层竞争格局。本章节将梳理核心企业动态与行业竞争壁垒。



# 全球竞争格局

## 高端垄断与中低端主导并存

01

### 高端市场

日本日东纺、旭化成等企业凭借技术积累，垄断全球高端低介电、石英电子布市场，占据高端领域 80% 以上市场份额。

02

### 中低端市场

中国大陆企业依托规模化产能和成本优势，主导中低端普通电子布市场，并持续向高端领域突破。

03

### 国产替代加速

在供应链安全战略驱动下，国内下游企业加速替换海外供应商，为国内企业高端产品放量提供了绝佳机遇。

# 国内核心企业

## 产能扩张与技术突破并进

### 01

#### 中国巨石

全球玻纤行业绝对龙头，电子布产能体量全球第一，依托全产业链布局形成极致成本优势，持续扩张高端产能。

### 02

#### 宏和科技

全球超薄电子布细分领域龙头，其 9 $\mu$ m 超薄电子布打破日本垄断，市占率超 30%，重点布局 AI 服务器高端产品。

### 03

#### 国际复材

国内中低端电子布核心供应商，产品广泛配套中低端覆铜板企业，受益于全球普通电子布产能收缩，业绩弹性持续释放。

### 04

#### 菲利华

国内稀缺的 AI 专用石英布量产企业，突破海外技术垄断，高端石英布产品毛利率超 60%，是高端景气周期的核心受益者。

# 行业核心壁垒

## 构筑头部企业护城河

1

### 设备壁垒

高端进口织机价格高昂、交付周期长，中小厂商难以承担大额设备投入，产能扩张能力不足。

2

### 技术壁垒

高端电子布对各项性能指标要求严苛，技术突破难度大，需要长期的研发迭代与工艺积累。

3

### 认证壁垒

下游头部客户认证周期长达 2-3 年，合作关系稳定，新进入者难以切入核心供应链。

4

### 人才壁垒

高端电子布生产工艺师、精密操作人才培养周期 1-2 年，行业专业人才稀缺，制约中小厂商产能与品质升级。



## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

者  
应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。